

# D2PAK (TO-263)

D2PAK 符合 JEDEC 的大功率电源分立产品标准 (TO-263)。

## 应用

D2PAK 适用于大功率应用 (100A 以上)，且专为低导通电阻和高速切换式 MOSFET 而量身定制。

- ▶ 电机驱动器
- ▶ 电源电路
- ▶ DC-DC 转换器
- ▶ 适用于汽车车身、安全和照明的关键应用

## 可靠性认证

Amkor 封装采用成熟可靠的半导体材料。全部可靠性测试包括：

- ▶ JEDEC 标准预处理，高温存储除外
- ▶ 85°C/85% 相对湿度，168 个小时，IR 回流焊 260°C 3X
- ▶ H<sup>3</sup>TRB：85°C/85% 相对湿度，1000 个小时
- ▶ uHAST：130°C/85% 相对湿度，96 小时
- ▶ 温度循环 -55°C/+150°C，1000 次循环
- ▶ 高温储存：150°C，1000 个小时

## 测试服务

Amkor 为全部功率分立器件提供完全一站式的服务，我们有能力测试各种类型的电源器件，包括 MOSFET、智能电源器件，等等。

- ▶ 功率分立器件测试能力
  - ▷ 直流
  - ▷ 电容 \*1
  - ▷ Rg \*1
  - ▷ 雪崩测试
  - ▷ 热阻
- ▶ 程序转换
- ▶ 电气故障分析
- ▶ 集成测试、打标、外观检查和卷带式包装服务

\*1 仅抽样试验

## 特色

- ▶ 采用粗铝焊线，以实现低导通电阻与高电流密度
- ▶ 从晶圆切割到成品测试与包装的一站式服务
- ▶ 绿色材料：无铅电镀和无卤素模塑化合物

## 正在开发

- ▶ 晶粒贴装采用保护环境的无铅焊膏

## 工艺亮点

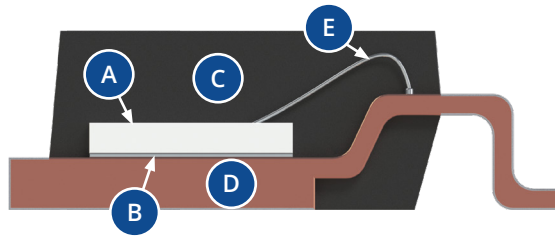
- ▶ 互连：粗铝线焊接技术
- ▶ 电镀：100% 雾锡
- ▶ 打标：激光打标
- ▶ 100% 汽车级自动外观检查

# D2PAK (TO-263)

## 标准材料

- ▶ 引线框架：裸铜
- ▶ 晶粒贴装：含铅焊膏
- ▶ 互连：铝线
- ▶ 模塑化合物：无卤素

## 横截面



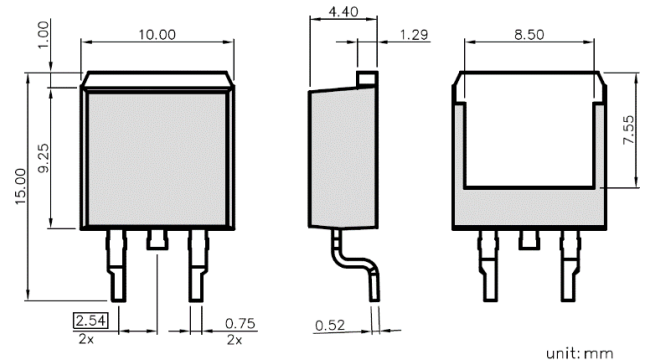
- A 晶粒
- B 晶片贴装
- C 模塑化合物
- D 引脚框架
- E 铝线

## 装运

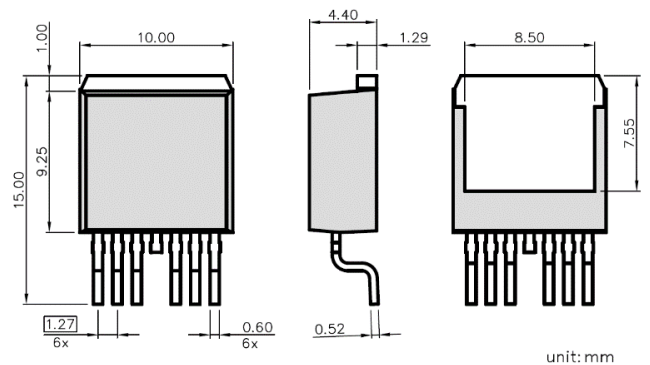
- ▶ 卷带式包装
  - ▷ 每卷 800 颗
  - ▷ 卷带宽度 24 毫米
  - ▷ 每卷直径 = 330 毫米
- ▶ 条形码封装标签

## 封装外形图

### D2PAK



### D2PAK 7L



访问 [amkor.com](http://amkor.com) 或发送电子邮件至 [sales@amkor.com](mailto:sales@amkor.com) 以获得更多信息。

关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。© 2020 Amkor Technology, Incorporated. 保留所有权利。DS417A-CN 修改日期：05/20

